IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: Mutsumi YANO, et al.

Group Art Unit: Not Yet Assigned

Serial No.: Not Yet Assigned

Examiner: Not Yet Assigned

Filed: **July 3, 2003**

For: ELECTROLYTIC CAPACITOR AND A FABRICATION METHOD THEREFOR

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Date: July 3, 2003

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications are hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

Japanese Appln. No. 2002-217482, filed July 26, 2002 Japanese Appln. No. 2003-080792, filed March 24, 2003

In support of this claim, the requisite certified copies of said original foreign applications are filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicants have complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copies.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. <u>01-2340</u>.

Respectfully submitted,

ARMSTRONG, WESTERMAN & HATTORI, LLP

Mel R. Quintos Attorney for Applicants Reg. No. 31,898

MRQ/jaz Atty. Docket No. **030744** Suite 1000 1725 K Street, N.W. Washington, D.C. 20006 (202) 659-2930

PATENT TRADEMARK OFFICE

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月26日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-217482

[ST.10/C]:

[JP2002-217482]

出 願 人 Applicant(s):

^{5):} 三洋電機株式会社

2003年 3月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-217482

【書類名】 特許願

【整理番号】 NPA1021015

【提出日】 平成14年 7月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01G 9/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内

【氏名】 矢野 睦

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内

【氏名】 高谷 和宏

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内

【氏名】 木本 衛

【特許出願人】

【識別番号】 000001889

【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代表者】 桑野 幸徳

【代理人】

【識別番号】 100087572

【弁理士】

【氏名又は名称】 松川 克明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009656

【納付金額】 21,000円

特2002-217482

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9401514

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電解コンデンサ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ニオブ合金、チタン合金及びタングステン合金から選択される1種を用いた電極が陽極酸化されて、この電極の表面に誘電体層が形成されていることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項2】 請求項1に記載の電解コンデンサにおいて、上記の電極に用いるニオブ合金が、ニオブに対してタングステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも1種の添加金属が添加されて合金化されたものであることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項3】 請求項1に記載の電解コンデンサにおいて、上記の電極に用いるチタン合金が、チタンに対してタングステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも1種の添加金属が添加されて合金化されたものであることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項4】 請求項1に記載の電解コンデンサにおいて、上記の電極に用いるタングステン合金が、タングステンに対してニオブ、チタン、タンタル、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも1種の添加金属が添加されて合金化されたものであることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項5】 請求項2~4の何れか1項に記載した電解コンデンサにおいて、上記の合金中における添加金属の含有量が0.01~5wt%の範囲になっていることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項6】 ニオブ又はニオブ合金からなる電極にフッ素がドープされ、 この電極が陽極酸化されて誘電体層が形成されていることを特徴とする電解コン デンサ。

【請求項7】 ニオブ又はニオブ合金からなる電極をフッ素ガス雰囲気中で 熱処理してフッ素をドープさせた後、この電極を陽極酸化させて、この電極の表 面に誘電体層を形成することを特徴とする電解コンデンサの製造方法。

【請求項8】 請求項7に記載した電解コンデンサの製造方法において、上記の熱処理する温度が200℃以下であることを特徴とする電解コンデンサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、電極が陽極酸化されて、この電極の表面に誘電体層が形成されてなる電解コンデンサに係り、特に、陽極酸化時に誘電体層の結晶化が進んで、誘電体層の絶縁性が低下するのを抑制し、電解コンデンサにおける漏れ電流を少なくなるようにした点に特徴を有するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、電子機器の小型化に伴って、小型で大容量のコンデンサの開発が要望されるようになった。

[0003]

そして、このような大容量のコンデンサとして、近年においては、特開平5-121275公報に示されるように、電極にチタンを用い、この電極を陽極酸化させて酸化チタンからなる誘電体層を形成した電解コンデンサや、特開平11-312628公報に示されるように、整流作用を有する陽極酸化が可能なアルミニウム、タンタル、ニオブ、チタン等の弁作用金属の粉末の焼成体からなる電極を陽極酸化させて、この電極の表面にこれらの金属酸化物からなる誘電体層を形成した電解コンデンサが提案されている。

[0004]

しかし、上記のように陽極酸化が可能なアルミニウム,タンタル,ニオブ,チタン等の弁作用金属を用いた電極を陽極酸化させて、この電極の表面にこれらの金属酸化物からなる誘電体層を形成するようにした場合、陽極酸化時にこれらの金属酸化物の結晶化が進み、これによって誘電体層の絶縁性が低下し、このような電解コンデンサにおける漏れ電流が増大するという問題があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

この発明は、上記のように電極を陽極酸化させて、この電極の表面に誘電体層を形成するようにした電解コンデンサにおける上記のような問題を解決することを課題とするものであり、陽極酸化時において誘電体層の結晶化が進んで、誘電体層の絶縁性が低下するのを抑制し、漏れ電流の発生の少ない電解コンデンサが得られるようにすることを課題とするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】

この発明における第1の電解コンデンサにおいては、上記のような課題を解決するため、電極にニオブ合金、チタン合金及びタングステン合金から選択される1種の合金を用い、この電極を陽極酸化させて、その表面に誘電体層を形成するようにしたのである。

[0007]

そして、この第1の電解コンデンサのように、電極にニオブ合金、チタン合金 及びタングステン合金から選択される1種の合金を用いると、ニオブやチタンや タングステン単体の金属を用いた場合に比べて、陽極酸化時に誘電体層が結晶化 するのが抑制され、誘電体層の絶縁性が低下するのが防止されて、漏れ電流の発 生の少ない電解コンデンサが得られるようになる。

[0008]

ここで、上記の二オブ合金の種類については特に限定されないが、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのを適切に抑制するためには、二オブに対してタングステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも1種の添加金属が添加されて合金化されたニオブ合金を用いることが好ましい。

[0009]

また、上記のチタン合金の種類についても特に限定されないが、陽極酸化時に おいて誘電体層が結晶化するのを適切に抑制するためには、チタンに対してタン グステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジル コニウムから選択される少なくとも1種の添加金属が添加されて合金化されたチ タン合金を用いることが好ましい。

[0010]

さらに、上記のタングステン合金の種類についても特に限定されないが、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのを適切に抑制するためには、タングステンに対してニオブ、チタン、タンタル、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも1種の添加金属が添加されて合金化されたタングステン合金を用いることが好ましい。

[0011]

また、上記のニオブ合金やチタン合金やタングステン合金において、上記のように添加させる添加金属の量が少ないと、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのを適切に抑制することができなくなり、また添加金属の量が多くなり過ぎても、同様に陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのを適切に抑制することができなくなるため、上記の各合金中における添加金属の含有量が0.01~5 wt%の範囲になるようにすることが好ましい。

[0012]

また、この発明における第2の電解コンデンサにおいては、上記のような課題 を解決するため、ニオブ又はニオブ合金からなる電極にフッ素をドープさせ、こ の電極を陽極酸化させて誘電体層を形成するようにしたのである。

[0013]

そして、この第2の電解コンデンサのように、ニオブ又はニオブ合金からなる電極にフッ素をドープさせ、この電極を陽極酸化させると、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのが、ドープされたフッ素によって抑制され、誘電体層の絶縁性が低下するのが防止されて、漏れ電流の発生の少ない電解コンデンサが得られるようになる。

[0014]

ここで、この第2の電解コンデンサにおいて、電極を構成する材料にニオブ合金を用いると、前記のように陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのがさらに抑制されるようになる。また、このニオブ合金としては、前記のようにニオブ

に対して前記のような添加金属を添加させて合金化させたニオブ合金を用いることがより好ましく、さらにこのニオブ合金中における添加金属の含有量も上記のような範囲にすることが好ましい。

[0015]

そして、上記の第2の電解コンデンサを製造するにあたっては、ニオブ又はニオブ合金からなる電極をフッ素ガス雰囲気中で熱処理してフッ素をドープさせた後、この電極を陽極酸化させて、この電極の表面に誘電体層を形成させるようにする。

[0016]

こでて、上記のようにニオブ又はニオブ合金からなる電極をフッ素ガス雰囲気中で熱処理してフッ素をドープさせるにあたり、熱処理する温度がフッ化ニオブの沸点である 225 でを越えると、フッ素を適切にドープさせることができなくなるため、熱処理する温度を 200 で以下にすることが好ましく、より好ましくは、40 で150 の温度で熱処理させるようにする。

[0017]

【実施例】

以下、この発明の実施例に係る電解コンデンサについて具体的に説明すると共に、比較例を挙げ、この発明の実施例に係る電解コンデンサにおいては、誘電体層が結晶化するのが抑制されて、漏れ電流の発生の少なくなることを明らかにする。なお、この発明の電解コンデンサは下記の実施例に示したものに限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲において適宜変更して実施できるものである。

[0018]

(実施例A1)

この実施例においては、ニオブ (Nb)粉末99gに対して、添加金属として タングステン (W)粉末を1g添加し、これらを回転揺動式混合装置により20 分間混合させた。そして、この混合粉末を真空中において1500℃で厚さ10 0μmになるまで加圧し、ニオブ中にタングステンが拡散されて合金化されたニ オブ合金箔を作製した。 [0019]

そして、このニオブ合金箔を1 c m×5 c mの大きさに切断した後、このニオブ合金箔を、液温を60℃にした0.6体積%の燐酸水溶液中において、30 V の定電圧で陽極酸化させて、このニオブ合金箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。

[0020]

そして、このように表面に誘電体層が形成されたニオブ合金箔からなる電極を 陽極に用い、図1に示すように、ビーカ1に収容させた2wt%のホウ酸水溶液 2中に上記の陽極3を浸漬させると共に、この陽極3の周囲を覆うようにして、 活性炭で構成された円筒状の陰極4をこの陽極3と接触しないようにして、上記 のホウ酸水溶液2中に浸漬させて、実施例A1の試験用電解コンデンサを作製し た。

[0021]

(実施例A2)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例A1の場合と変更し、ニオブ粉末99gに対して、バナジウム(V)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例A2の試験用電解コンデンサを作製した。

[0022]

(実施例A3)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施 例A1の場合と変更し、ニオブ粉末99gに対して、亜鉛(Zn)粉末を1g加 えるようにし、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例A3 の試験用電解コンデンサを作製した。

[0023]

(実施例A4)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施 例A1の場合と変更し、ニオブ粉末99gに対して、アルミニウム(A1)粉末 を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実 施例A4の試験用電解コンデンサを作製した。

[0024]

(実施例A5)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例A1の場合と変更し、ニオブ粉末99gに対して、モリブデン(Mo)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例A5の試験用電解コンデンサを作製した。

[0025]

(実施例A6)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例A1の場合と変更し、ニオブ粉末99gに対して、ジルコニウム(Zr)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例A6の試験用電解コンデンサを作製した。

[0026]

(実施例A7)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施 例A1の場合と変更し、ニオブ粉末99gに対して、ハフニウム (Hf) 粉末を 1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施 例A7の試験用電解コンデンサを作製した。

[0027]

(実施例A8)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施 例A1の場合と変更し、ニオブ粉末99gに対して、亜鉛粉末0.5gとアルミニウム粉末0.5gとを加えるようにし、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例A8の試験用電解コンデンサを作製した。

[0028]

(比較例 a 1)

この比較例においては、上記の実施例A1において、ニオブ粉末に対して添加 金属のタングステン粉末を加えないようにして、ニオブだけで構成されたニオブ 箔を作製し、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、比較例a1の 試験用電解コンデンサを作製した。

[0029]

(実施例B1)

この実施例においては、チタン(Ti)粉末99gに対して、添加金属としてバナジウム(V)粉末を1g加え、上記の実施例A1の場合と同様に、これらを回転揺動式混合装置により20分間混合させた後、この混合粉末を真空中において1500℃で厚さ100 μ mになるまで加圧し、チタン中にバナジウムが拡散されて合金化されたチタン合金箔を作製した。

[0030]

そして、このチタン合金箔を、上記の実施例A1の場合と同様に、1cm×5cmの大きさに切断した後、このチタン合金箔を、液温を60℃にした0.6体積%の燐酸水溶液中において、30Vの定電圧で陽極酸化させて、このチタン合金箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。

[0031]

そして、このように表面に誘電体層が形成されたチタン合金箔からなる電極を 陽極に用い、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例B1の 試験用電解コンデンサを作製した。

[0032]

(比較例 b 1)

この比較例においては、上記の実施例B1において、チタン粉末に対して添加 金属のバナジウム粉末を加えないようにして、チタンだけで構成されたチタン箔 を作製し、それ以外は、上記の実施例B1の場合と同様にして、比較例b1の試 験用電解コンデンサを作製した。

[0033]

次いで、上記のように作製した実施例A1~A8,B1及び比較例a1,b1 の各試験用電解コンデンサを使用し、それぞれ20Vに保持して、2秒後の漏れ 電流を測定した。そして、上記の実施例A1の試験用電解コンデンサにおける漏 れ電流値を100とした指数で、各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を 求め、その結果を下記の表1に示した。

[0034]

【表1】

	電極の組成(重量比)	漏れ電流値
実施例A1	Nb:W = 99:1	1 0 0
実施例A2	Nb: V = 99:1	98
実施例A3	Nb:Zn = 99:1	101
実施例A4	Nb:Al = 99:1	9 6
実施例A5	Nb : Mo = 99 : 1	102
実施例A6	Nb:Zr = 99:1	103
実施例A7	Nb: Hf = 99:1	9 7
実施例A8	Nb: $Zn:Al=99:0.5:0.5$	105
上較例 a 1	N b = 1 0 0	250
実施例B1	Ti:V = 99:1	180
比較例 b 1	T i = 1 0 0	500

[0035]

この結果から明らかなように、ニオブに対してタングステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ジルコニウム及びハフニウムから選択される少なくとも1種の添加金属を添加させて合金化させたニオブ合金からなる電極を陽極酸化させたものを用いた実施例A1~A8の各試験用電解コンデンサは、ニオブだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例a1の試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が大きく減少していた。

[0036]

また、チタンに対して、添加金属としてバナジウムを添加させて合金化させた

チタン合金からなる電極を陽極酸化させたものを用いた実施例B1の試験用電解コンデンサも、チタンだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例 b 1の試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が大きく減少していた。なお、チタンに対して、バナジウム以外のタングステン、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ジルコニウム及びハフニウムから選択される少なくとも1種の添加金属を添加させて合金化させたチタン合金からなる電極を陽極酸化させたものを用いた場合においても、同様の効果が得られる。

[0037]

(実施例A1.1~A1.7)

これらの実施例A1.1~A1.7においては、ニオブ(Nb)粉末に対して添加金属として添加させるタングステン(W)粉末の割合を、前記の実施例A1の場合と変更させて、ニオブ合金中におけるタングステンの含有量(wt%)を下記の表2に示すように変更させたニオブ合金箔を作製し、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例A1.1~A1.7の各試験用電解コンデンサを作製した。

[0038]

そして、このように作製した実施例A1.1~A1.7の各試験用電解コンデンサについても、上記の場合と同様にして、漏れ電流を測定し、上記の実施例A1の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を100とした指数で、各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表2に示した。

[0039]

【表2】

	N b 合金中のW含有量(w t %)	漏れ電流値
実施例A1. 1	0.005	2 2 0
実施例A1.2	0.01	1 2 0
実施例A1.3	0. 1	110
実施例A1.4	0. 5	105
実施例A1	1. 0	100
実施例A1.5	2. 5	107
実施例A1. 6	5. 0	1 2 7
実施例A1.7	7. 5	200

[0040]

この結果から明らかなように、ニオブ合金中におけるタングステンの含有量が 0.01~5 w t %の範囲になったものを用いた実施例 A 1.2~A 1.6 及び A 1 の各試験用電解コンデンサにおいて漏れ電流値が低くなっており、特に、タングステンの含有量が 0.1~2.5 w t %の範囲になったものを用いた実施例 A 1.3~A 1.5 及び A 1 の各試験用電解コンデンサにおいてはさらに漏れ電流値が低くなっていた。なお、ニオブに対して、タングステン以外のバナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン及びジルコニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属を添加させて合金化させたニオブ合金についても同様の結果が得られる。

[0041]

(実施例C1)

この実施例においては、タングステン(W)粉末99gに対して、添加金属としてニオブ(N b)粉末を1g加え、上記の実施例A1の場合と同様に、これらを回転揺動式混合装置により20分間混合させた後、この混合粉末を真空中において1500℃で厚さ100μmになるまで加圧し、タングステン中にニオブが

拡散されて合金化されたタングステン合金箔を作製した。

[0042]

そして、このタングステン合金箔を、上記の実施例A1の場合と同様に、1cm×5cmの大きさに切断した後、このタングステン合金箔を、液温を60℃にした0.6体積%の燐酸水溶液中において、30Vの定電圧で陽極酸化させて、このタングステン合金箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。

[0043]

そして、このように表面に誘電体層が形成されたタングステン合金箔からなる電極を陽極に用い、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例C1の試験用電解コンデンサを作製した。

[0044]

(実施例C2)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例C1の場合と変更し、タングステン粉末99gに対して、チタン (Ti)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C2の試験用電解コンデンサを作製した。

[0045]

(実施例C3)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例C1の場合と変更し、タングステン粉末99gに対して、タンタル(Ta)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C3の試験用電解コンデンサを作製した。

[0046]

(実施例C4)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例C1の場合と変更し、タングステン粉末99gに対して、バナジウム(V)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C4の試験用電解コンデンサを作製した。

[0047]

(実施例C5)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例C1の場合と変更し、タングステン粉末99gに対して、亜鉛(Zn)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C5の試験用電解コンデンサを作製した。

[0048]

(実施例C6)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例C1の場合と変更し、タングステン粉末99gに対して、アルミニウム(A1)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C6の試験用電解コンデンサを作製した。

[0049]

(実施例C7)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例C1の場合と変更し、タングステン粉末99gに対して、モリブデン(Mo)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C7の試験用電解コンデンサを作製した。

[0050]

(実施例C8)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例C1の場合と変更し、タングステン粉末99gに対して、ジルコニウム(Zr)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C8の試験用電解コンデンサを作製した。

[0051]

(実施例C9)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例C1の場合と変更し、タングステン粉末99gに対して、ハフニウム(Hf)粉末を1g加えるようにし、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C9の試験用電解コンデンサを作製した。

[0052]

(実施例C10)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例C1の場合と変更し、タングステン粉末99gに対して、タンタル粉末0.5gとニオブ粉末0.5gとを加えるようにし、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C10の試験用電解コンデンサを作製した。

[0053]

(比較例 c 1)

この比較例においては、上記の実施例C1において、タングステン粉末に対して添加金属のニオブ粉末を加えないようにして、タングステンだけで構成されたタングステン箔を作製し、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、比較例c1の試験用電解コンデンサを作製した。

[0054]

そして、このように作製した実施例C1~C10及び比較例c1の各試験用電解コンデンサと、参考のために前記の比較例a1及び比較例b1の各試験用電解コンデンサを使用し、それぞれ20Vに保持して、2秒後の漏れ電流を測定した。そして、上記の実施例C1の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を100とした指数で、上記の各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表3に示した。

[0055]

【表3】

	電極の組成(重	最比)	漏れ電流値
実施例С1	W:Nb	= 9 9 : 1	100
実施例C2	W:Ti	= 9 9 : 1	110
実施例 C 3	W : T a	= 9 9 : 1	9 6
実施例C4	W:V	= 9 9 : 1	98
実施例C5	W:Zn	= 9 9 : 1	106
実施例C6	W : A 1	= 9 9 : 1	97
実施例C7	W:Mo	= 9 9 : 1	112
実施例C8	W:Zr	= 9 9 : 1	102
実施例C9	W: H f	= 9 9 : 1	9 7
実施例C10	W:Ta:Nb	= 9 9 : 0 . 5 : 0 . 5	9 4
11.44.60			
比較例 c 1	W	= 1 0 0	600
比較例a 1	Nb	= 1 0 0	240
比較例 b 1	Тi	= 1 0 0	450

[0056]

この結果から明らかなように、タングステンに対して、ニオブ、チタン、タンタル、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ジルコニウム及びハフニウムから選択される少なくとも1種の添加金属を添加させて合金化させたタングステン合金からなる電極を陽極酸化させたものを用いた実施例C1~C10の各試験用電解コンデンサは、タングステンだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例c1の試験用電解コンデンサや、ニオブだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例a1の試験用電解コンデンや、チタンだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例b1の試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が大きく減少していた。

[0057]

(実施例C1.1~C1.7)

これらの実施例C1.1~C1.7においては、タングステン(W)粉末に対して、添加金属として添加させるニオブ(Nb)粉末の割合を、前記の実施例C1の場合と変更させて、タングステン合金中におけるニオブの含有量(wt%)を下記の表4に示すように変更させたタングステン合金箔を作製し、それ以外は、上記の実施例C1の場合と同様にして、実施例C1.1~C1.7の各試験用電解コンデンサを作製した。

[0058]

そして、このように作製した実施例C1.1~C1.7の各試験用電解コンデンサについても、上記の場合と同様にして、漏れ電流を測定し、上記の実施例C1の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を100とした指数で、各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表4に示した。

[0059]

【表4】

	W合金中のNb含有量(wt%)	漏れ電流値
実施例 С 1 . 1	0.005	2 2 0
実施例 С 1. 2	0.01	115
実施例C1. 3	0.1	108
実施例C1.4	0. 5	105
実施例C1	1. 0	100
実施例С1.5	2. 5	110
実施例 С 1 . 6	5. 0	117
実施例C1. 7	7. 5	210

[0060]

この結果から明らかなように、タングステン合金中におけるニオブの含有量が

0.01~5wt%の範囲になったものを用いた実施例C1.2~C1.6及びC1の各試験用電解コンデンサにおいて漏れ電流値が低くなっており、特に、タングステンの含有量が0.1~2.5wt%の範囲になったものを用いた実施例C1.3~C1.5及びC1の各試験用電解コンデンサにおいてはさらに漏れ電流値が低くなっていた。なお、タングステンに対して、ニオブ以外のチタン、タンタル、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ジルコニウム及びハフニウムから選択される少なくとも1種の添加金属を添加させて合金化させたタングステン合金についても同様の結果が得られる。

[0061]

(実施例D1)

この実施例においては、前記の比較例 a 1 の場合と同様にして、ニオブだけで構成された、厚さが1 0 0 μ m,大きさが1 c m× 5 c mになったニオブ箔からなる電極を作製した後、この電極をフッ素ガス雰囲気中において6 0 $\mathbb C$ で 1 時間熱処理して、この電極中にフッ素をドープさせた。

[0062]

そして、このようにフッ素がドープされた電極を、液温を60℃にした0.6 体積%の燐酸水溶液中において30Vの定電圧で陽極酸化させて、このニオブ箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。ここで、このように形成した誘電体層をXPS(X線電子分光分析)によって分析したところ、この誘電体層中にフッ素がドープされていた。

[0063]

次いで、このようにフッ素がドープされた誘電体層が形成されたニオブ箔からなる電極を陽極に用い、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例D1の試験用電解コンデンサを作製した。

[0064]

(実施例D2)

この実施例においては、前記の実施例A1の場合と同様にして、ニオブ合金中にタングステンが1wt%含有され、厚さが100μm,大きさが1cm×5cmになったニオブ合金箔からなる電極を作製した後、この電極をフッ素ガス雰囲

気中において60℃で1時間熱処理して、この電極中にフッ素をドープさせた。

[0065]

そして、このようにフッ素がドープされた電極を、液温を60℃にした0.6 体積%の燐酸水溶液中において30 Vの定電圧で陽極酸化させて、このニオブ合 金箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。ここで、このように形成した誘 電体層をXPS (X線電子分光分析)によって分析したところ、上記の実施例D 1の場合と同様に、この誘電体層中にフッ素がドープされていた。

[0066]

次いで、このようにフッ素がドープされた誘電体層が形成されたニオブ合金箔からなる電極を陽極に用い、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例D2の試験用電解コンデンサを作製した。

[0067]

そして、上記のように電極にフッ素をドープさせて陽極酸化させた電極を用いた実施例D1, D2の各試験用電解コンデンサと、参考のために電極にフッ素をドープさせずに陽極酸化させた電極を用い前記の比較例a1, 実施例A1の各試験用電解コンデンサを使用し、それぞれ20Vに保持して、2秒後の漏れ電流を測定した。そして、上記の実施例D1の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を100とした指数で、上記の各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表5に示した。

[0068]

【表5】

	電極の組成(重量比)	フッ素のドープ	漏れ電流値
	N b = 1 0 0 N b = 1 0 0	有無	1 2 5 2 7 0
実施例D2 実施例A1	Nb: W=99:1 Nb: W=99:1	有無	100

[0069]

この結果から明らかなように、電極中にフッ素をドープさせ、このようにフッ素がドープされた電極を陽極酸化させて、表面にフッ素がドープされた誘電体層を形成した電極を使用した実施例D1, D2の各試験用電解コンデンサは、電極中にフッ素をドープさせなかった対応する比較例a1, 実施例A1の各試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が小さくなっていた。

[0070]

(実施例D1.1~D1.6)

これらの実施例D1.1~D1.6においては、上記の実施例D1において、 ニオブ箔からなる電極をフッ素ガス雰囲気中で熱処理する温度だけを下記の表6 に示すように変更し、それ以外は、上記の実施例D1の場合と同様にして、実施 例D1.1~D1.6の各試験用電解コンデンサを作製した。

[0071]

そして、このように作製した実施例D1.1~D1.6の各試験用電解コンデンサについても、上記の場合と同様にして、漏れ電流を測定し、上記の実施例D1の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を100とした指数で、各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表6に示した。

[0072]

【表 6】

	熱処理温度(℃)	漏れ電流値
実施例D1.1	3 0	1 1 5
実施例D1.2	4 0	102
実施例D1	6 0	100
実施例D1.3	100	102
実施例D1.4	150	105
実施例D1.5	200	110
実施例D1.6	2 2 5	2 1 5

[0073]

この結果から明らかなように、電極をフッ素ガス雰囲気中で熱処理して、電極中にフッ素をドープさせるにあたり、その熱処理温度をフッ化ニオブの沸点である225℃より低い30~200℃の範囲にした実施例D1, D1.1~D1.5の各試験用電解コンデンサは、熱処理温度をフッ化ニオブの沸点である225℃にした実施例D1.6の試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が小さくなっており、特に熱処理温度を40~150℃の範囲にした実施例D1, D1.2~D1.4の試験用電解コンデンサにおいては、さらに漏れ電流が少なくなっていた。

[0074]

【発明の効果】

以上詳述したように、この発明における第1の電解コンデンサにおいては、電極にニオブ合金、チタン合金及びタングステン合金から選択される1種の合金を用い、この電極を陽極酸化させて、その表面に誘電体層を形成するようにしたため、ニオブやチタンやタングステン単体の金属を電極に用いる場合に比べて、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのが抑制され、誘電体層の絶縁性が低下するのが防止されて、漏れ電流の発生の少ない電解コンデンサが得られるように

なった。

[0075]

また、この発明における第2の電解コンデンサにおいては、ニオブ又はニオブ 合金からなる電極にフッ素をドープさせ、この電極を陽極酸化させて誘電体層を 形成するようにしたため、この陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのが抑 制され、誘電体層の絶縁性が低下するのが防止されて、漏れ電流の発生の少ない 電解コンデンサが得られるようになった。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の各実施例及び各比較例において作製した試験用電解コンデンサの概略説明図である。

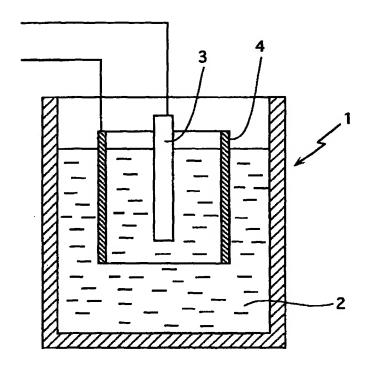
【符号の説明】

- 3 陽極
- 4 陰極

【書類名】

図面

【図1】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 電極を陽極酸化させて、表面に誘電体層を形成するようにした電解コンデンサにおいて、陽極酸化時に誘電体層の絶縁性が低下するのを抑制して、漏れ電流の発生の少ない電解コンデンサが得られるようにする。

【解決手段】 第1の電解コンデンサにおいては、電極3にニオブ合金、チタン合金及びタングステン合金から選択される1種の合金を用い、この電極3を陽極酸化させてその表面に誘電体層を形成し、また第2の電解コンデンサにおいては、ニオブ又はニオブ合金を用いた電極3にフッ素をドープさせ、この電極3を陽極酸化させて誘電体層を形成した。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000001889]

1. 変更年月日

1993年10月20日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

氏 名

三洋電機株式会社